PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-016797

(43)Date of publication of application: 22.01.1999

(51)Int.CI.

H01L 21/02

G05B 23/02 G05B 23/02

(21)Application number: 09-164288

(71)Applicant: TOKYO ELECTRON LTD

(22)Date of filing:

20.06.1997

(72)Inventor: NAKAMA KAZUHISA

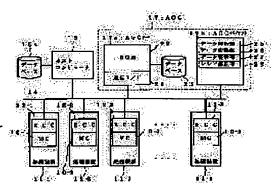
TODATE SHIGENORI MATSUDA KATSUHIKO

(54) CONTROL SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance maintainability of the entire production system in the case of a system where a plurality of processors for substrates to be processed, e.g. semiconductor wafers. are controlled under integrated management.

SOLUTION: The control system is connected additionally with an AGC (advance group controller) 17 performing analysis of all process data obtained from each processor 11, as well as central management of recipe (process condition values) for each processor or process control thereof based on the recipe, monitoring the analytical results or process data centrally and reflecting the analytical/statistic results on the recipe. Since all process data and analytical results from each processor 11 can be monitored, abnormal or deteriorated state of the processor can be detected in detail on the early stage.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.06.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3512594

[Date of registration]

16.01.2004

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-16797

(43)公開日 平成11年(1999)1月22日

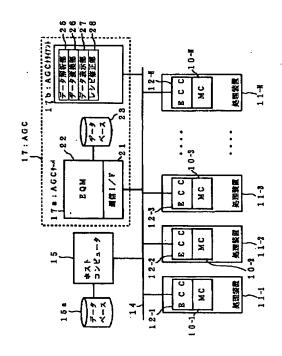
識別記号	FI H01L 2	21/02 Z
-	G05B 2	23/02 3 0 1 U
3 0 2	3 0 2 S	
	審査請求	: 未請求 請求項の数3 OL (全 7 頁)
持顧平9-164288	(71)出願人	000219967
		東京エレクトロン株式会社
(22)出願日 平成9年(1997)6月20日		東京都港区赤坂5丁目3番6号
	(72)発明者	中間 和久 東京都府中市住吉町2-30-7 東京エレ クトロン株式会社内
	(72)発明者	戸舘 重典
		東京都府中市住吉町2-30-7 東京エレクトロン株式会社内
	(72)発明者	松田 克彦
		東京都府中市住吉町2-30-7 東京エレ
	6	クトロン株式会社内
	(74)代理人	弁理士 須山 佐一
	3 0 1 3 0 2	田

(54)【発明の名称】 制御システム

(57)【要約】

【課題】 半導体ウェハ等の被処理基板を処理する複数の処理装置を一元管理の下で制御するシステム形態とした場合の、製造システム全体の保守性の向上を図る。

【解決手段】 各処理装置毎のレシビ(ブロセス条件値)の集中管理やレシビに基づく各処理装置11のブロセスコントロールをはじめとして、各処理装置11から得られる全てのブロセスデータの集中モニタリング処理、更には解析/統計結果をレシビに反映させる処理等を行うAGC(アドバンス・グループ・コントローラ)を制御システムに付加接続する。各処理装置11から得られる全てのブロセスデータやその解析結果をモニタリングできることで、処理装置の異常や劣化状態をより詳細かつ早期に発見することができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被処理基板に対する所定のプロセスを行 う複数の処理装置を個別に制御する複数の制御装置と、 前記各制御装置より受信したプロセスデータに基づいて 前記各制御装置を制御するホストコンピュータと、 前記各制御装置より受信したプロセスデータを収集する 手段、前記収集したプロセスデータを解析する手段、お よび前記解析の結果を出力する手段を有するコントロー ル装置とを具備し、

前記個々の制御装置は、プロセスデータを生成する手 段、前記生成されたプロセスデータの中から予め設定さ れた一部のプロセスデータを前記ホストコンピュータに 送信する手段、および前記生成された全てのプロセスデ ータを前記コントロール装置に送信する手段を有すると とを特徴とする制御システム。

【請求項2】 被処理基板に対する所定のプロセスを行 う複数の処理装置を個別に制御する複数の制御装置と、 前記各制御装置より受信したプロセスデータに基づいて 前記各制御装置を制御するホストコンピュータと、 前記各制御装置より受信したプロセスデータを収集する 20 手段、前記収集したプロセスデータを解析する手段、お

よび前記解析の結果に基づいて前記各処理装置のプロセ ス条件を更新する手段を有するコントロール装置とを具 備し、

前記個々の制御装置は、プロセスデータを生成する手 段、前記生成されたプロセスデータの中から予め設定さ れた一部のプロセスデータを前記ホストコンピュータに 送信する手段、および前記生成された全てのプロセスデ ータを前記コントロール装置に送信する手段を有すると とを特徴とする制御システム。

【請求項3】 被処理基板に対する所定のプロセスを行 う複数の処理装置を個別に制御する複数の制御装置と、 前記各制御装置より受信した一部のプロセスデータに基 づいて前記各制御装置を制御するホストコンピュータ と、

前記各制御装置より受信したプロセスデータを収集する 手段、前記収集したプロセスデータを解析する手段、前 記解析の結果を出力する手段、および前記収集したプロ セスデータで前記ホストコンピュータのプロセスデータ 受信不能期間の欠落プロセスデータを補填する手段を有 40 するコントロール装置とを具備し、

前記個々の制御装置は、プロセスデータを生成する手 段、前記生成されたプロセスデータの中から予め設定さ れた一部のプロセスデータを前記ホストコンピュータに 送信する手段、および前記生成された全てのプロセスデ ータを前記コントロール装置に送信する手段を有すると とを特徴とする制御システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

装置、液晶パネル製造装置等の製造装置を制御するシス テムに係り、特に複数の基板処理装置を一元管理する機 能を持った制御システムに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体ウエハや液晶パネル等の製 造システムの大規模化により、被処理基板に対して成膜 処理、エッチング処理、熱酸化処理等の処理(プロセ ス)を行う多数の処理装置を一元管理する要求が益々高 まっている。

10 【0003】図5にこのような複数処理装置の一元管理 機能を持った制御システムの構成を示す。

【0004】同図において、31 (31-1~31-N) は 被処理基板に対する各種処理を行う処理装置、32(3 2-1~32-N) は各処理装置31を個別に制御するEC C制御部である。ECC制御部32は、ホストコンピュ ータ35との論理的なインターフェイス手段であるHC I (Host Communication Interface) 33を有し、この HCI33によって、ホストコンピュータ35との間で の各種データのやりとりがTCP/IP等のデータ伝送 系34を通じて行われる。ホストコンピュータ35は、 各処理装置31のECC制御部32との間での各種デー タをやりとりを通じて各処理装置31のトラッキング処 理を行うとともに、各処理装置31より受信したプロセ スデータをデータベース35aに履歴として蓄積し、そ の内容をモニタに表示したり、そのプロセスデータに基 づいて処理装置31の各種パラメータ補正や異常検出等 を行う。

【0005】各処理装置31のECC制御部32からホ ストコンピュータ35へのプロセスデータ転送の際、H CI33は、ECC制御部32にて生成された全プロセ 30 スデータの中からトラッキング処理、パラメータ補正、 異常検出等に最低限必要とされる一部の種類のデータだ けを選択してホストコンピュータ35に送信する。 [0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな制御システムによる一元管理方式では、ホストコン ピュータに蓄積されるプロセスデータが限定されること になり、モニタに表示されたプロセスデータから各処理 装置の状態として獲得できる情報も制限されたものとな る。また、処理装置の経年的な特性の劣化状態を反映し たプロセスデータの変化等は、モニタに表示されたプロ セスデータを単に参照しただけでは発見できない場合が 多い。このような事情から、処理装置の異常や特性劣化 を確実且つ早期に発見することは現実的に難しいという 問題があった。

【0007】本発明はこのような事情によりなされたも のであり、各処理装置のより詳細な一元管理を実現して 保守性の向上を図れる制御システムの提供を目的として また、本発明は、プロセスデータの解析結果を いる。 【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体製造 50 通しての各処理装置の詳細な一元管理を実現して、処理 装置の異常や特性劣化の早期発見に寄与することのできる制御システムの提供を目的としている。

【0008】加えて、本発明は、各処理装置のプロセス 条件の自動的な最適化を実現した制御システムの提供を 目的としている。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の制御システムは、請求項1に記載されるように、被処理基板に対する所定のプロセスを行う複数の処理装置を個別に制御する複数の制御装置と、前記各制 10 御装置より受信したプロセスデータに基づいて前記各制御装置を制御するホストコンピュータと、前記各制御装置より受信したプロセスデータを収集する手段、前記収集したプロセスデータを解析する手段、および前記解析の結果を出力する手段を有するコントロール装置とを具備し、前記個々の制御装置は、プロセスデータを生成する手段、前記生成されたプロセスデータの中から予め設定された一部のプロセスデータを前記ホストコンピュータに送信する手段、および前記生成された全てのプロセスデータを前記コントロール装置に送信する手段を有す 20 ることを特徴とする。

【0010】すなわち、この発明において、コントロール装置は各処理装置の制御装置で生成された全てのブロセスデータを解析してその結果を出力するので、従来のホストコンピュータ上で一部のブロセスデータを集中モニタリングする方式に比べ、各処理装置の状態として掴み得る情報の幅が広がり、各処理装置の状態の経時的な変化も早期に発見することができる。

【0011】また、本発明の制御システムは、請求項2に記載されるように、被処理基板に対する所定のプロセ 30 スを行う複数の処理装置を個別に制御する複数の制御装置と、前記各制御装置より受信したプロセスデータに基づいて前記各制御装置より受信したプロセスデータを収集する手段、前記収集したプロセスデータを解析する手段、および前記解析の結果に基づいて前記各処理装置のプロセス条件を更新する手段を有するコントロール装置とを具備し、前記個々の制御装置は、プロセスデータを生成する手段、前記生成されたプロセスデータの中から予め設定された一部のプロセスデータを前記ホストコン 40 ピュータに送信する手段、および前記生成された全てのプロセスデータを前記コントロール装置に送信する手段を有することを特徴とする。

【0012】との発明は、各制御装置にて生成された全てのプロセスデータの解析結果に基づいてプロセス条件を更新する手段をさらに設けたことによって、各処理装置の経時的な特性の変動をも考慮した様々な観点から最適なプロセス条件を自動的に得ることが可能となり、プロセス条件設定のための人為的な試行錯誤を不要なものとすることができる。

【0013】さらに、本発明の制御システムは、請求項 3に記載されるように、被処理基板に対する所定のプロ セスを行う複数の処理装置を個別に制御する複数の制御 装置と、前記各制御装置より受信した一部のプロセスデ ータに基づいて前記各制御装置を制御するホストコンピ ュータと、前記各制御装置より受信したプロセスデータ を収集する手段、前記収集したプロセスデータを解析す る手段、前記解析の結果を出力する手段、および前記収 集したプロセスデータで前記ホストコンピュータのプロ セスデータ受信不能期間の欠落プロセスデータを補填す る手段を有するコントロール装置とを具備し、前記個々 の制御装置は、プロセスデータを生成する手段、前記生 成されたプロセスデータの中から予め設定された一部の プロセスデータを前記ホストコンピュータに送信する手 段、および前記生成された全てのプロセスデータを前記 コントロール装置に送信する手段を有することを特徴と する。

【0014】本発明は、コントロール装置で収集したプロセスデータでホストコンピュータのプロセスデータ受信不能期間の欠落プロセスデータを補填する手段をさらに設けたことで、ホストコンピュータはダウン状態から復旧した直後より、各各処理装置の制御装置に対する制御を直ちに再開することができる。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施する場合の形態について図面に基づいて説明する。

【0016】本発明に係る制御システムは、例えば次のような複合プロセス型の半導体ウエハ製造装置等に適用される。

【0017】図1に示すように、この半導体ウエハ製造 装置は、半導体ウエハに対して各種の処理例えば成膜処 理やエッチング処理や熱酸化処理等を行う複数例えば3 つののプロセスチャンパ1、2、3と、多数枚例えば25 枚のウエハWを収納できるカセットC1、C2を収容す るカセットチャンパ4、5と、プロセスチャンパ1、 2、3とカセットチャンバ4、5との間でウエハWの受 け渡しを行う搬送チャンバ6とを備えて構成される。各 チャンパ間はゲートバルブGを介して開閉自在に連結さ れている。搬送チャンバ6内には、屈伸動作及び回転動 40 作が可能な例えば多関節式の搬送アーム7が設けられて おり、この搬送アーム7によりチャンバ間でのウェハ♥ の搬送が行われる。カセットC1、C2はカセットチャ ンパ4、5内に取り込まれる際に90度反転されると共に そのカセットC1、C2のウエハ挿脱□が搬送チャンバ 6内の中心を向くように回転され、以て搬送アーム7に よるウエハ♥の出し入れが可能な姿勢に設置される。 【0018】図2は本発明の第1の実施形態である制御 システムの全体的な構成を示すブロック図である。

【0019】同図において、11(11-1~11-N)は 50 例えば成膜処理、エッチング処理、熱酸化処理等の被処

理基板に対する各種処理を行う処理装置、12(12-1 ~12-N) は各処理装置11の上位制御系であるECC 制御部、10(10-1~10-N)は各処理装置11の下 位制御系であるMC (マシンコントローラ) である。図 3に示すように、ECC制御部12は、ホストコンピュ ータ15との論理的なインターフェイス手段であるHC I(Host Communication Interface)13を有し、この HCI13によって、ホストコンピュータ15との間で の各種データのやりとりがTCP/IP等のデータ伝送 系14を通じて行われる。また、ECC制御部12は、 アドバンスド・グループ・コントローラ (以下、AGC と称す。) 17との論理的なインターフェイス手段であ るRAP (Remote Agent Process) 16を有し、このR AP16によってAGC17との間での各種データのや りとりがデータ伝送系14を通じて行われる。

【0020】ととで、プロセステータ転送に係るHCI 13とRAP16の機能の違いについて説明する。

【0021】HCI13は、ECC制御部12にて処理 装置11から得た全てのプロセスデータの中から予め設 定された一部の種類のプロセスデータだけを選択してホ 20 ストコンピュータ15に送信する。すなわち、図3にお いて、18はECC制御部12にて生成された全プロセ スデータが一時的に蓄積されるメモリであり、HCI1 3は、このメモリ18から予め設定された一部の種類の プロセスデータ(データ1、3)を取り出してHCI送 信バッファ19に書き込み、HCI送信バッファ19の 内容をまとめてホストコンピュータ15に送信する。ま た、ECC制御部12で生成されたステータスデータ等 も送信される。

【0022】RAP16は、ECC制御部12にて処理 30 装置11から得た全てのプロセスデータを無条件にAG C17に送信する。すなわち、RAP16は、ECC制 御部12内のプロセスデータ蓄積用メモリ18に蓄積さ れたプロセスデータを先頭から順次読み出し、そのデー タ構造のままAGC17に転送する。但し、データの順 番を並び換えたり、どく一部のデータを排除する程度の 操作をことで行ってもよい。

【0023】ホストコンピュータ15は、各処理装置1 1のECC制御部12との間での各種データをやりとり を通じて各処理装置11のトラッキング処理を行うなど 40 各処理装置11の全体的な動作制御を行う。

【0024】AGC17は、各処理装置毎のレシビ(プ ロセス条件値)の集中管理やレシビに基づく各処理装置 11のプロセスコントロールをはじめとして、各処理装 置11から得られる全てのプロセスデータを対象に、そ の解析処理、統計処理、プロセスデータやその解析/統 計結果の集中モニタリング処理、更には解析/統計結果 をレシピに反映させる処理等を行う。

【0025】AGC17はAGCサーバ17aとAGC クライアント17bから構成されている。AGCサーバ 50 【0032】また、AGCサーバ17aは、AGCクラ

17aの通信 I / F (インターフェース部) 21は、各 処理装置11のECC制御部12およびAGCクライア ント17 b との間でデータ伝送系14を通じて各種テー タを送受信する。 EQM制御部22は、予め定義された プロセス条件と各処理装置11から得られるプロセスデ ータに基づいて処理装置毎のプロセスの各種パラメータ 補正を行うとともに、受信したパラメータのデータベー ス23への格納、およびAGCクライアント17bに転 送すべきプロセスデータをデータベース23から検索す 10 る処理等を主に行う。

【0026】AGCクライアント17bには、AGCサ ーバ17aより転送されてきたプロセスデータの解析処 理および統計処理を行うデータ解析部25と、取り込ん だプロセスデータやその解析結果等をクライアントユー ザの利用・加工可能な形式のデータに変換するデータ変 換部26と、変換データをモニタ等に表示するデータ表 示部27と、被処理基板上の膜厚等の測定データを含む プロセスデータの解析結果に基づいてレシピ(プロセス 条件)を最適化するように更新するレシピ修正部28等 の機能が用意されている。

【0027】次に、とのシステムの動作をAGCの関与 する動作を中心に説明する。

【0028】まず各処理装置11のECC制御部12 は、AGC17よるプロセスコントロールの下、対応す る処理装置 1 1 を制御して被処理基板に対する処理を実

【0029】個々のECC制御部12にて処理装置11 から得たプロセスデータは、図3に示したプロセスデー タ蓄積用メモリ18に書き込まれる。プロセスデータ蓄 積用メモリ18に書き込まれたプロセスデータは、その 外部転送に係る論理的なインターフェイス手段であるH CI13とRAP16によって、TCP/IP等のデー タ伝送系14の独立したチャンネルを通じてホストコン ピュータ15とAGC17に転送される。

【0030】ここで、HCI13は、プロセスデータ蓄 積用メモリ18に保持されたすべてのプロセスデータの 中から予め設定された一部の種類のプロセスデータだけ を引き出してHCI送信バッファ19に書き込み、HC 【送信バッファ19の内容をデータ伝送系14を通じて ホストコンピュータ15に送信する。一方、RAP16 は、プロセスデータ蓄積用メモリ18から全てのプロセ スデータを読み出してAGC17に転送する。

【0031】AGC17 (AGCサーバ17a) は、各 処理装置のECC制御部12のRAP16によって送信 されたプロセスデータを受信し、このプロセスデータを データベース23に蓄積するとともに、このプロセスデ ータとレシビデータから各処理装置のパラメータ補正値 を生成してこれをECC制御部12に送信することによ ってプロセスコントロールを行う。

イアント17bからプロセステータ転送要求を受ける と、データベース23から該当するプロセスデータを読 み出し、通信I/F21を通じてAGCクライアント1 7 b に送信する。 A G C クライアント 1 7 b に転送され たプロセスデータは、データ変換部26にてクライアン トユーザの利用・加工可能な形式のデータに変換され、 データ表示部27によってモニタに表示される。さら に、AGCクライアント17bに転送されたプロセスデ ータは、データ解析部25にて解析および統計処理さ れ、その解析結果はデータ変換部26にてプロセスデー 10 タと同様にユーザ利用可能な形式のデータに変換され、 モニタに表示される。 これにより AGC クライアント1 7 b 上での基板処理システム全体の一元管理が実現され

【0033】また、AGCクライアント17bのデータ 解析部25は、プロセスデータの解析結果から処理装置 の異常検出や異常予測を行い、異常を検出した場合およ び予測した場合は、その旨をデータ表示部27を通して モニタに出力するとともにAGCサーバ17aに通知す る。この通知に従ってAGCサーバ17aは、例えば、 異常検出或いは異常予測された処理装置11を制御して いるECC制御部12に対して処理装置の停止を指示す るなどの制御を行う。

【0034】さらに、AGCクライアント17bのレシ ビ修正部28は、基板上の膜厚測定結果等の測定データ を含むプロセスデータに対する解析結果からレシピ(プ ロセス条件)を最適化するための更新処理を行う。

【0035】また、本実施形態では、ホストコンピュー タ15がダウンした場合にAGC17によるプロセスデ ータのスプーリング処理が行われる。すなわち、ホスト コンピュータ15は、復旧後、ダウン期間のプロセスデ ータをAGC17から直ちに取り込むことができる。と れにより、ホストコンピュータ15による各処理装置1 1のトラッキング処理を復旧後直ちに再開することがで きる。

【0036】以上説明したように、本実施形態の制御シ ステムによれば、各処理装置から得られる全て或いはほ ぼ全ての詳細なプロセスデータをAGC17に取り込ん で集中モニタリングすることができるので、各処理装置 の状態として掴むことのできる情報の幅が広がり、処理 40 装置の異常や劣化状態をより詳細かつ早期に発見すると とができる。また、各処理装置から得られる全て或いは ほぼ全ての詳細なブロセスデータを解析してその解説結 果を集中モニタリングすることができるので、各処理装 置の状態の経時的な変化を早期に発見することができ る。これにより、多数の処理装置からなる製造システム の保守信頼性を髙めることが可能となる。また、本実施 形態では、基板上の膜厚測定結果等の測定データを含む 詳細なプロセスデータに対する解析結果や統計結果から レシビにおける各データをより好ましい値に更新すると 50 構成を示すブロック図

とによって、各処理装置の経時的な特性の変動をも考慮 した様々な観点から最適なプロセス条件を自動的に得る ことが可能となり、信頼性の向上を図ることができる。 【0037】さらに、AGC17をハード的にプロセス データ収集用のAGCサーバ17aと、そのプロセスデ ータを実際に運用するAGCクライアント17bとに別 けたことで、各々の制御負荷が分散され、より多数の処 理装置を接続した構成においても性能が低下することが なくなる。

【0038】なお、以上説明した実施形態において、A GC17は一台のAGCサーバ17aと一台のAGCク ライアント17bとで構成したが、処理装置の接続数が さらに増大した場合、AGCサーバ17aの負荷が非常 に大きくなることが予想される。そとで、図4に示すよ うに、機能例えばレシピの種類毎にAGCサーバ17a (17a-1~17a-M)を設ける形態をとる方式が考え られる。 とのような形態をとった場合、個々のAGCサ ーバの機能をバージョンアップしたり保守点検を行う際 に、他のAGCサーバの管理下にある処理装置群の動作 を止める必要がなくなり、システム全体の処理効率を高 めるととが可能となる。

[0039]

30

【発明の効果】以上説明したように本発明の請求項1の 制御システムによれば、コントロール装置は各処理装置 の制御装置で生成された全てのプロセスデータを解析し てその結果を出力するので、従来のホストコンピュータ 上で一部のプロセスデータを集中モニタリングする方式 に比べ、各処理装置の状態として掴み得る情報の幅が広 がり、各処理装置の状態の経時的な変化も早期に発見す るととができる。

【0040】また、本発明の請求項2の制御システムに よれば、各制御装置にて生成された全てのプロセスデー タの解析結果に基づいてプロセス条件を更新する手段を さらに設けたことによって、各処理装置の経時的な特性 の変動をも考慮した様々な観点から最適なプロセス条件 を自動的に得ることが可能となり、プロセス条件設定の ための人為的な試行錯誤を不要なものとすることができ る。

【0041】さらに、本発明の請求項3の制御システム によれば、コントロール装置で収集したプロセスデータ でホストコンピュータのプロセスデータ受信不能期間の 欠落プロセスデータを補填する手段をさらに設けたこと で、ホストコンピュータはダウン状態から復旧した直後 より、各各処理装置の制御装置に対する制御を直ちに再 開することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る制御システムの制御対象である複 合プロセス型の半導体ウエハ製造装置の構成を示す図 【図2】本発明の第1の実施形態である制御システムの

10

【図3】図2のECC制御部におけるプロセステータ転 送に係る部分の構成を示す図

【図4】本発明の第2の実施形態である制御システムの 構成を示すブロック図

【図5】従来の制御システムの全体的な構成を示すブロ ック図

【符号の説明】

11(11-1~11-N)……処理装置

12 (12-1~12-N) ……ECC制御部

13 ······ HCI

14……データ伝送路

15……ホストコンピュータ

*16 RAP

17 AGC

17a……AGCサーバ

17b……AGCクライアント

21……通信I/F

22 ····· E QM制御部

23……データベース

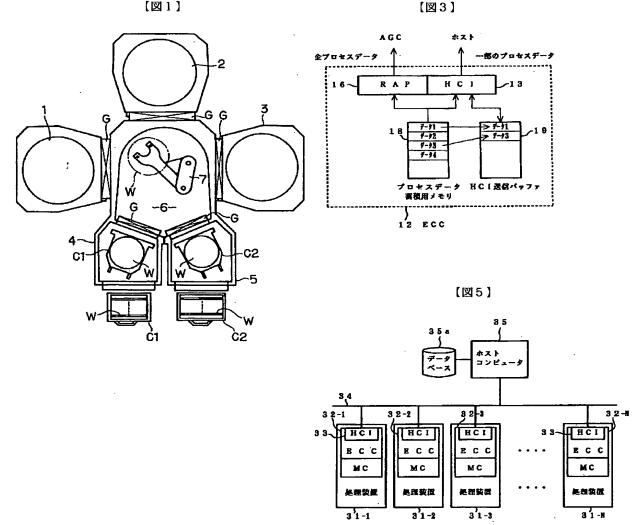
25……データ解析部

26……データ変換部

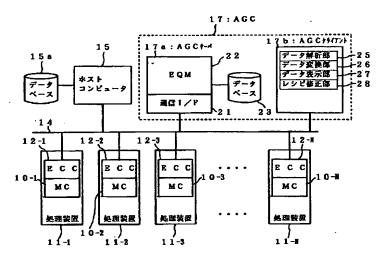
10 27 ……データ表示部

28 …… レシピ修正部

【図1】



【図2】



【図4】

